



H2005 环氧粘接胶

H2005 是一款单组分环氧粘接胶，应用于芯片组装、LED 透镜、手机指纹模组、手机镜头等热敏感零部件粘接。固化后粘接强度高，且对塑料、金属等基材有高粘合力。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	半透明液体
组分	单组分
固化方式	热固化
应用	粘接
典型的产品应用	LED 显示板粘接等

产品优点

- 对金属、PCB 等材料具有良好的粘接强度
- 良好的绝缘性能
- 耐候性能优异

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	1500±500	GB/T 2794, 50s
触变指数	1.5±0.5	GB/T 2794, 5s /50s
比重 g/cm ³	1.4±0.1	GB/T 13354
工作时间	1.5 天	@ 25° C, 25% 粘度上升

固化后性能

在推荐的条件下固化：

条目			典型值	备注
物理性能	热膨胀系数 ppm/°C	Tg 以下	62	ASTM D696
		Tg 以上	120	



	玻璃化转变温度(Tg)	46℃	ASTM E228
	硬度 Shore D	65D	ISO 868
	剪切强度 (Al/Al) MPa	9	ISO 13445
	剪切强度 (Al/Al) MPa	10	ISO 13445,65℃/90RH/170H
	剪切强度 (PCB/PCB) MPa	16 (材料面断裂)	ISO 13445
	剪切强度 (PCB/PCB) MPa	16 (材料面断裂)	ISO 13445,65℃/90RH/170H

典型的固化性能

固化条件

条目	典型值
热固化	30 分钟 @80℃
	60 分钟 @60℃

以上固化条件仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用说明

在使用前必须恢复到室温，在恢复到室温以前请不要打开铝箔包装(建议回温时间大于 4 小时)。胶水对湿度敏感，请不要将胶水长时间暴露在空气中，建议使用环境相对湿度低于 60%，回温次数不超过三次。

本品在 25℃，相对湿度 < 60%的条件下，使用期是 1.5 天。

未用完的胶，请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱贮存。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

- 10ml , 30ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。



将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-40℃~-20℃，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com